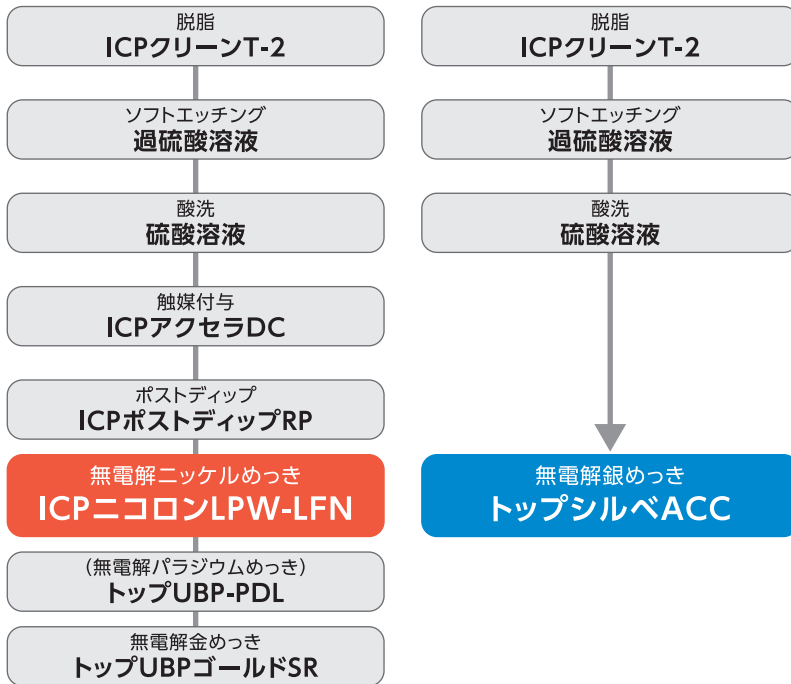


# 無電解めっきプロセス

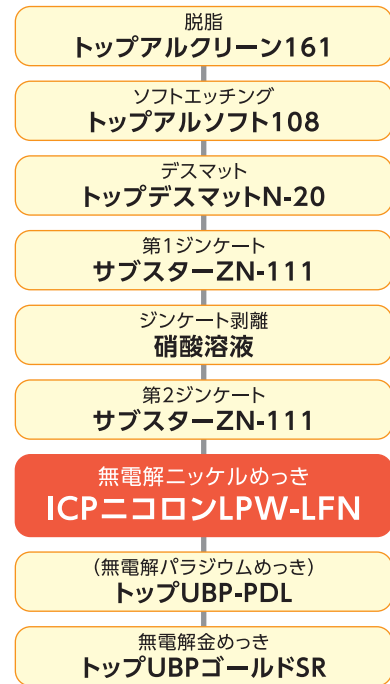
銅/アルミ張セラミック基板用

- はんだ接合性に優れた無電解ニッケル/(パラジウム)/金めっきプロセス
- 銀ナノ粒子を用いた焼結接合に対応、下地銅の腐食を抑制する無電解銀めっき液

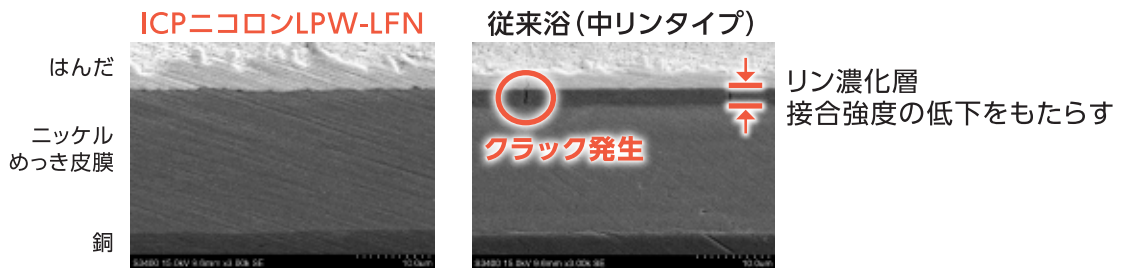
## 銅張セラミック基板用



## アルミ張セラミック基板用



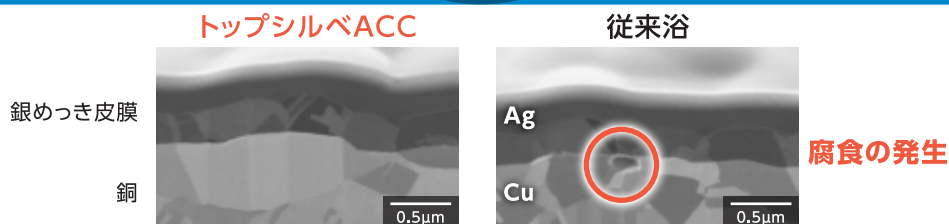
## 無電解ニッケルめっき：高温環境下ではんだ接合性に優れる



**ニッケルのはんだへの拡散を抑制、接合信頼性を確保**

【はんだ接合条件】 はんだ: Sn-3.0 Ag-0.5 Cu、接合後に200℃で300時間放置

## 無電解銀めっき：下地銅への腐食を抑制



**はんだ接合に代わる技術として注目される銀ナノ焼結接合に対応**